

30/03/2004

English

科大機械工程教授獲殊榮

香港科技大學（科大）機械工程學系主任余同希教授及副教授李世瑋博士獲美國機械工程師學會選為2003年度會士，以表彰他們對機械工程專業作出的重要貢獻。

該會會長Reginald I Vachon博士今天（2004年3月30日）訪問科大，並將會士狀頒授予余教授與李博士。

美國機械工程師學會於1880年創辦，會員125,000人，是全球領先的機械工程師專業組織。只有2%會員獲選為會士。

這些榮譽代表了國際學術及工業界對科大機械工程學系促進優質教學，致力推進與香港經濟發展相關研究的認同。該系近年專注研究開發能源與熱能系統、電子封裝、微機電系統、先進工程材料及精密工程，與本地工業界建立緊密的合作關係。

在一項有關全球首20個機械工程學系研究成果的調查中，按科學論文引述指數的資料顯示，科大機械工程學系的教授在2000-2003年刊登的研究論文平均數目位居全球前三位，與普林斯頓大學、史丹福大學、加州理工大學及伊利諾依大學相若，在2003年更名列前茅。

余教授表示：“我們的目標是提供高素質的教育，發展成全球領先的機械工程學系。現在，我們的研究成果又逐步向世界一流大學看齊，成績令人鼓舞。”

余教授是研究衝擊動力學、塑性力學及能量吸收材料的專家，曾發表逾240篇學術期刊論文，合作撰寫了八本專著，並出任九份著名學術期刊的編委會成員。他的學術成就屢獲肯定：劍橋大學於1995年頒授科學博士學位；2001年獲中國高教科技一等獎及2002年的IFAI論壇工業紡織品優秀論文獎等。他亦獲英國機械工程師學會選為2003年度會士。

自2002年起，余教授出任科大集成微系統研究所所長。他並積極為香港工業界提供工程失效分析及交通意外重組等顧問服務。

余教授於1964年在北京大學畢業，1983年在劍橋大學獲博士學位。在1984年至1991年，他在北大力學系任教，其後在英國的曼徹斯特理工大學出任教授。1995年，余教授加入科大。

李世瑋博士是科大電子封裝研究中心主任，專研電子封裝，芯片倒裝及表面貼裝技術，集成電路封裝失效分析及電子器件的可靠性測試。他已發表逾100篇學術論文，合撰了三本有關電子封裝的專著，並曾兩度（2000年及2001年）獲頒美國機械工程師學會電子封裝期刊最佳論文獎。此外，他還擔任四份國際學術期刊的編審委員。

李博士曾是美國機械工程師學會香港分會副會長（1997年至1998年），IEEE-CPMT香港分會會長（2001年至2003



美國機械工程師學會會長Vachon博士（右）頒授會士狀予余同希教授（上圖）及李世瑋博士（下圖）

年)。李博士在1992年獲美國普度大學頒授航天及航空工程博士學位，1993年加入科大。